

L29信息披露

证券代码:688525 证券简称:佰维存储 公告编号:2026-090

深圳佰维存储科技股份有限公司 关于召开2026年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2026年10月12日
- 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
- 召开会议的基本程序

- (一) 股东大会类型和届次
- 2026年第四次临时股东大会
- (二) 股东大会召集人:董事会
- (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开日期:2026年10月12日 14:00-17:00
- 召开地点:广东省深圳市南山区留仙大道3370号南山智园望安园区2号楼3楼T2国际会议厅
- (五) 网络投票系统的起止时间
- 网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
- 投票起止时间:自2026年10月12日
- 至2026年10月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	A
2	《关于增聘2026年度内部控制审计机构的议案》	V

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,相关公告于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第四次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:2
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案:0

三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股股份相同类别股份的总量之和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的数量,分别以各类别和该品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 为了更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司使用上海证券信息科技股份有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东投票服务(即“一键通”),委托上证信息通过短信短信等方式,根据投票登记信息及时推送主动提醒股东大会参会信息,向每一位投资者发送主动提醒股东大会邀请,以提醒参会信息。投资者在收到提醒短信后,可根据上市公司股东大会网络投票“一键通服务”用户使用手册(链接:https://www.sseinfo.com/tj/yj_bkhp.pdf)的提示步骤直接投票,如网络投票等情况,仍可通过原有的交易系统平台参与互联网投票平台进行投票。

四、会议登记对象
(一) 股权登记日下午收盘时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权利出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
人民币普通股	688525	佰维存储	2026/9/30

(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。

五、会议登记方式
(一) 登记时间:2026年10月8日上午9:00-12:00,下午13:30-18:00
(二) 登记地点:深圳市南山区桃园街道众冠花园2栋4楼3公司1号会议室

(三) 登记方式:
1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和股票;授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代表出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、合伙企业由授权执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或者合伙企业授权代表出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有执行事务合伙人或者其委派代表资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、合伙企业股东授权执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

4、股东可按照上述要求以信函、电子邮件、现场的方式方式进行登记,信函到达戳记和电子邮件到达日期以2026年10月10日18:00,信函、电子邮件件到达日期以2026年10月10日18:00为准。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

(一) 出席会议者交通费由股东(或代理人)自理。
(二) 参会股东投票前半小时到达会议现场办理签到。参会代表请务必携带有效身份证件,以备核验身份。

(三) 会议联系方式
1、联系人:黄秋林
2、联系电话:0755-27615701
3、会议地点:深圳市南山区桃园街道众冠花园2栋4楼3公司1号会议室
4、电子邮箱:ir@hivm.com.cn

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
2026年9月23日

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
授权委托书

深圳佰维存储科技股份有限公司,
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年10月12日召开的贵公司2026年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

受托人签名(盖章):
受托人身份证号码:
受托人身份证号码:
受托人身份证号码:
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688525 证券简称:佰维存储 公告编号:2026-087

深圳佰维存储科技股份有限公司 关于与东莞松山湖高新技术产业开发区 管理委员会签订项目合作协议 暨对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称:晶品级先进封装制造项目三期(以下简称“本项目”)
- 投资金额:深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称“公司”)、控股子公司广东芯汉奇半导体技术有限公司(以下简称“广东芯汉奇”)拟与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订

《晶品级先进封装制造项目三期合作协议》(以下简称“本协议”),预计晶品级先进封装制造项目三期(以下简称“本项目”)总投资45亿元人民币,最终以项目建设实际投资开支为准(包括建筑物、构筑物及附属设施、设备投资等)。具体将根据本项目实际进展分阶段投入,最终以项目建设实际投资开支为准。

● 交易实施所需履行的审批及其他相关程序
2026年9月21日召开第四届董事会第二十三次会议,全体董事审议通过了《关于与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订项目合作协议暨对外投资的议案》,公司拟在前期项目投资额的基础上再增加投资约45亿元人民币,最终以项目建设实际投资开支为准(包括建筑物、构筑物及附属设施、设备投资等)。具体将根据本项目实际进展分阶段投入,最终以项目建设实际投资开支为准。

● 晶品级先进封装制造项目一期、二期进展情况
1、投资进展情况:晶品级先进封装制造项目一期、二期计划(具体详见2023年10月28日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订项目合作协议暨对外投资的公告》)已于2023年9月已完成,设备陆续交付中,对应产能约3,000片(2.5D产能)。截至本公告披露日,一期项目已完工,房建设及设备安装调试,二期项目设备陆续进场安装调试,目前处于客户试产、工艺验证及小批量试产阶段,尚未正式产生量产收益。

2、技术准备情况:广东芯汉奇已建成2.5D、2.0D、Fan-out Fan-out等多种先进封装技术。本次二期项目系在前期项目基础上进行的技术升级,建设内容项目与前期项目无本质区别,不涉及新增用地。

● 其他需要提醒投资者重点关注的事项
1、本项目是基于公司战略发展的需要以及对行业市场前景的判断,但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性;项目投入建设后,受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素影响,最终实际实施、生产情况具有不确定性,可能存在未能按期建设完成或未能达到预期收益的风险;

2、广东芯汉奇作为本项目经营实体,承担本协议项下的权利和义务。如果广东芯汉奇无法履约时,公司对广东芯汉奇违反本协议条款的行为承担补充责任,补充责任以公司对广东芯汉奇所持股份比例为限。

(二) 对外投资概述
1、本次交易概述
基于公司的发展战略需要,为把握市场发展机遇,提升公司市场竞争力和综合实力,公司、控股子公司广东芯汉奇(作为晶品级先进封装制造项目一期、二期(以下简称“原项目”),三期实施主体),拟与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订《晶品级先进封装制造项目三期合作协议》。本项目总投资额约为45亿元人民币(最终以项目建设实际投资开支为准)。其中固定资产投资40亿元(包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资)。

2、本次交易的主要内容
● 投资标的名称:晶品级先进封装制造项目三期(以下简称“本项目”)

● 投资金额:深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称“公司”)、控股子公司广东芯汉奇半导体技术有限公司(以下简称“广东芯汉奇”)拟与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订

《晶品级先进封装制造项目三期合作协议》(以下简称“本协议”),预计晶品级先进封装制造项目三期(以下简称“本项目”)总投资45亿元人民币,最终以项目建设实际投资开支为准(包括建筑物、构筑物及附属设施、设备投资等)。具体将根据本项目实际进展分阶段投入,最终以项目建设实际投资开支为准。

● 交易实施所需履行的审批及其他相关程序
2026年9月21日召开第四届董事会第二十三次会议,全体董事审议通过了《关于与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订项目合作协议暨对外投资的议案》,公司拟在前期项目投资额的基础上再增加投资约45亿元人民币,最终以项目建设实际投资开支为准(包括建筑物、构筑物及附属设施、设备投资等)。具体将根据本项目实际进展分阶段投入,最终以项目建设实际投资开支为准。

● 晶品级先进封装制造项目一期、二期进展情况
1、投资进展情况:晶品级先进封装制造项目一期、二期计划(具体详见2023年10月28日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订项目合作协议暨对外投资的公告》)已于2023年9月已完成,设备陆续交付中,对应产能约3,000片(2.5D产能)。截至本公告披露日,一期项目已完工,房建设及设备安装调试,二期项目设备陆续进场安装调试,目前处于客户试产、工艺验证及小批量试产阶段,尚未正式产生量产收益。

2、技术准备情况:广东芯汉奇已建成2.5D、2.0D、Fan-out Fan-out等多种先进封装技术。本次二期项目系在前期项目基础上进行的技术升级,建设内容项目与前期项目无本质区别,不涉及新增用地。

● 其他需要提醒投资者重点关注的事项
1、本项目是基于公司战略发展的需要以及对行业市场前景的判断,但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性;项目投入建设后,受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素影响,最终实际实施、生产情况具有不确定性,可能存在未能按期建设完成或未能达到预期收益的风险;

2、广东芯汉奇作为本项目经营实体,承担本协议项下的权利和义务。如果广东芯汉奇无法履约时,公司对广东芯汉奇违反本协议条款的行为承担补充责任,补充责任以公司对广东芯汉奇所持股份比例为限。

(二) 对外投资概述
1、本次交易概述
基于公司的发展战略需要,为把握市场发展机遇,提升公司市场竞争力和综合实力,公司、控股子公司广东芯汉奇(作为晶品级先进封装制造项目一期、二期(以下简称“原项目”),三期实施主体),拟与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订《晶品级先进封装制造项目三期合作协议》。本项目总投资额约为45亿元人民币(最终以项目建设实际投资开支为准)。其中固定资产投资40亿元(包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资)。

2、本次交易的主要内容
● 投资标的名称:晶品级先进封装制造项目三期(以下简称“本项目”)

● 投资金额:深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称“公司”)、控股子公司广东芯汉奇半导体技术有限公司(以下简称“广东芯汉奇”)拟与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订

《晶品级先进封装制造项目三期合作协议》(以下简称“本协议”),预计晶品级先进封装制造项目三期(以下简称“本项目”)总投资45亿元人民币,最终以项目建设实际投资开支为准(包括建筑物、构筑物及附属设施、设备投资等)。具体将根据本项目实际进展分阶段投入,最终以项目建设实际投资开支为准。

● 交易实施所需履行的审批及其他相关程序
2026年9月21日召开第四届董事会第二十三次会议,全体董事审议通过了《关于与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订项目合作协议暨对外投资的议案》,公司拟在前期项目投资额的基础上再增加投资约45亿元人民币,最终以项目建设实际投资开支为准(包括建筑物、构筑物及附属设施、设备投资等)。具体将根据本项目实际进展分阶段投入,最终以项目建设实际投资开支为准。

● 晶品级先进封装制造项目一期、二期进展情况
1、投资进展情况:晶品级先进封装制造项目一期、二期计划(具体详见2023年10月28日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订项目合作协议暨对外投资的公告》)已于2023年9月已完成,设备陆续交付中,对应产能约3,000片(2.5D产能)。截至本公告披露日,一期项目已完工,房建设及设备安装调试,二期项目设备陆续进场安装调试,目前处于客户试产、工艺验证及小批量试产阶段,尚未正式产生量产收益。

2、技术准备情况:广东芯汉奇已建成2.5D、2.0D、Fan-out Fan-out等多种先进封装技术。本次二期项目系在前期项目基础上进行的技术升级,建设内容项目与前期项目无本质区别,不涉及新增用地。

● 其他需要提醒投资者重点关注的事项
1、本项目是基于公司战略发展的需要以及对行业市场前景的判断,但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性;项目投入建设后,受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素影响,最终实际实施、生产情况具有不确定性,可能存在未能按期建设完成或未能达到预期收益的风险;

2、广东芯汉奇作为本项目经营实体,承担本协议项下的权利和义务。如果广东芯汉奇无法履约时,公司对广东芯汉奇违反本协议条款的行为承担补充责任,补充责任以公司对广东芯汉奇所持股份比例为限。

(二) 对外投资概述
1、本次交易概述
基于公司的发展战略需要,为把握市场发展机遇,提升公司市场竞争力和综合实力,公司、控股子公司广东芯汉奇(作为晶品级先进封装制造项目一期、二期(以下简称“原项目”),三期实施主体),拟与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订《晶品级先进封装制造项目三期合作协议》。本项目总投资额约为45亿元人民币(最终以项目建设实际投资开支为准)。其中固定资产投资40亿元(包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资)。

2、本次交易的主要内容
● 投资标的名称:晶品级先进封装制造项目三期(以下简称“本项目”)

● 投资金额:深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称“公司”)、控股子公司广东芯汉奇半导体技术有限公司(以下简称“广东芯汉奇”)拟与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订

《晶品级先进封装制造项目三期合作协议》(以下简称“本协议”),预计晶品级先进封装制造项目三期(以下简称“本项目”)总投资45亿元人民币,最终以项目建设实际投资开支为准(包括建筑物、构筑物及附属设施、设备投资等)。具体将根据本项目实际进展分阶段投入,最终以项目建设实际投资开支为准。

● 交易实施所需履行的审批及其他相关程序
2026年9月21日召开第四届董事会第二十三次会议,全体董事审议通过了《关于与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订项目合作协议暨对外投资的议案》,公司拟在前期项目投资额的基础上再增加投资约45亿元人民币,最终以项目建设实际投资开支为准(包括建筑物、构筑物及附属设施、设备投资等)。具体将根据本项目实际进展分阶段投入,最终以项目建设实际投资开支为准。

● 晶品级先进封装制造项目一期、二期进展情况
1、投资进展情况:晶品级先进封装制造项目一期、二期计划(具体详见2023年10月28日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订项目合作协议暨对外投资的公告》)已于2023年9月已完成,设备陆续交付中,对应产能约3,000片(2.5D产能)。截至本公告披露日,一期项目已完工,房建设及设备安装调试,二期项目设备陆续进场安装调试,目前处于客户试产、工艺验证及小批量试产阶段,尚未正式产生量产收益。

2、技术准备情况:广东芯汉奇已建成2.5D、2.0D、Fan-out Fan-out等多种先进封装技术。本次二期项目系在前期项目基础上进行的技术升级,建设内容项目与前期项目无本质区别,不涉及新增用地。

● 其他需要提醒投资者重点关注的事项
1、本项目是基于公司战略发展的需要以及对行业市场前景的判断,但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性;项目投入建设后,受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素影响,最终实际实施、生产情况具有不确定性,可能存在未能按期建设完成或未能达到预期收益的风险;

2、广东芯汉奇作为本项目经营实体,承担本协议项下的权利和义务。如果广东芯汉奇无法履约时,公司对广东芯汉奇违反本协议条款的行为承担补充责任,补充责任以公司对广东芯汉奇所持股份比例为限。

(二) 对外投资概述
1、本次交易概述
基于公司的发展战略需要,为把握市场发展机遇,提升公司市场竞争力和综合实力,公司、控股子公司广东芯汉奇(作为晶品级先进封装制造项目一期、二期(以下简称“原项目”),三期实施主体),拟与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订《晶品级先进封装制造项目三期合作协议》。本项目总投资额约为45亿元人民币(最终以项目建设实际投资开支为准)。其中固定资产投资40亿元(包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资)。

2、本次交易的主要内容
● 投资标的名称:晶品级先进封装制造项目三期(以下简称“本项目”)

● 投资金额:深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称“公司”)、控股子公司广东芯汉奇半导体技术有限公司(以下简称“广东芯汉奇”)拟与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订

《晶品级先进封装制造项目三期合作协议》(以下简称“本协议”),预计晶品级先进封装制造项目三期(以下简称“本项目”)总投资45亿元人民币,最终以项目建设实际投资开支为准(包括建筑物、构筑物及附属设施、设备投资等)。具体将根据本项目实际进展分阶段投入,最终以项目建设实际投资开支为准。

● 交易实施所需履行的审批及其他相关程序
2026年9月21日召开第四届董事会第二十三次会议,全体董事审议通过了《关于与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订项目合作协议暨对外投资的议案》,公司拟在前期项目投资额的基础上再增加投资约45亿元人民币,最终以项目建设实际投资开支为准(包括建筑物、构筑物及附属设施、设备投资等)。具体将根据本项目实际进展分阶段投入,最终以项目建设实际投资开支为准。

● 晶品级先进封装制造项目一期、二期进展情况
1、投资进展情况:晶品级先进封装制造项目一期、二期计划(具体详见2023年10月28日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订项目合作协议暨对外投资的公告》)已于2023年9月已完成,设备陆续交付中,对应产能约3,000片(2.5D产能)。截至本公告披露日,一期项目已完工,房建设及设备安装调试,二期项目设备陆续进场安装调试,目前处于客户试产、工艺验证及小批量试产阶段,尚未正式产生量产收益。

2、技术准备情况:广东芯汉奇已建成2.5D、2.0D、Fan-out Fan-out等多种先进封装技术。本次二期项目系在前期项目基础上进行的技术升级,建设内容项目与前期项目无本质区别,不涉及新增用地。

● 其他需要提醒投资者重点关注的事项
1、本项目是基于公司战略发展的需要以及对行业市场前景的判断,但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性;项目投入建设后,受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素影响,最终实际实施、生产情况具有不确定性,可能存在未能按期建设完成或未能达到预期收益的风险;

2、广东芯汉奇作为本项目经营实体,承担本协议项下的权利和义务。如果广东芯汉奇无法履约时,公司对广东芯汉奇违反本协议条款的行为承担补充责任,补充责任以公司对广东芯汉奇所持股份比例为限。

(二) 对外投资概述
1、本次交易概述
基于公司的发展战略需要,为把握市场发展机遇,提升公司市场竞争力和综合实力,公司、控股子公司广东芯汉奇(作为晶品级先进封装制造项目一期、二期(以下简称“原项目”),三期实施主体),拟与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订《晶品级先进封装制造项目三期合作协议》。本项目总投资额约为45亿元人民币(最终以项目建设实际投资开支为准)。其中固定资产投资40亿元(包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资)。

2、本次交易的主要内容
● 投资标的名称:晶品级先进封装制造项目三期(以下简称“本项目”)

● 投资金额:深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称“公司”)、控股子公司广东芯汉奇半导体技术有限公司(以下简称“广东芯汉奇”)拟与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订

《晶品级先进封装制造项目三期合作协议》(以下简称“本协议”),预计晶品级先进封装制造项目三期(以下简称“本项目”)总投资45亿元人民币,最终以项目建设实际投资开支为准(包括建筑物、构筑物及附属设施、设备投资等)。具体将根据本项目实际进展分阶段投入,最终以项目建设实际投资开支为准。

● 交易实施所需履行的审批及其他相关程序
2026年9月21日召开第四届董事会第二十三次会议,全体董事审议通过了《关于与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订项目合作协议暨对外投资的议案》,公司拟在前期项目投资额的基础上再增加投资约45亿元人民币,最终以项目建设实际投资开支为准(包括建筑物、构筑物及附属设施、设备投资等)。具体将根据本项目实际进展分阶段投入,最终以项目建设实际投资开支为准。

● 晶品级先进封装制造项目一期、二期进展情况
1、投资进展情况:晶品级先进封装制造项目一期、二期计划(具体详见2023年10月28日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订项目合作协议暨对外投资的公告》)已于2023年9月已完成,设备陆续交付中,对应产能约3,000片(2.5D产能)。截至本公告披露日,一期项目已完工,房建设及设备安装调试,二期项目设备陆续进场安装调试,目前处于客户试产、工艺验证及小批量试产阶段,尚未正式产生量产收益。

2、技术准备情况:广东芯汉奇已建成2.5D、2.0D、Fan-out Fan-out等多种先进封装技术。本次二期项目系在前期项目基础上进行的技术升级,建设内容项目与前期项目无本质区别,不涉及新增用地。

● 其他需要提醒投资者重点关注的事项
1、本项目是基于公司战略发展的需要以及对行业市场前景的判断,但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性;项目投入建设后,受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素影响,最终实际实施、生产情况具有不确定性,可能存在未能按期建设完成或未能达到预期收益的风险;

2、广东芯汉奇作为本项目经营实体,承担本协议项下的权利和义务。如果广东芯汉奇无法履约时,公司对广东芯汉奇违反本协议条款的行为承担补充责任,补充责任以公司对广东芯汉奇所持股份比例为限。

(二) 对外投资概述
1、本次交易概述
基于公司的发展战略需要,为把握市场发展机遇,提升公司市场竞争力和综合实力,公司、控股子公司广东芯汉奇(作为晶品级先进封装制造项目一期、二期(以下简称“原项目”),三期实施主体),拟与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订《晶品级先进封装制造项目三期合作协议》。本项目总投资额约为45亿元人民币(最终以项目建设实际投资开支为准)。其中固定资产投资40亿元(包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资)。

2、本次交易的主要内容
● 投资标的名称:晶品级先进封装制造项目三期(以下简称“本项目”)

● 投资金额:深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称“公司”)、控股子公司广东芯汉奇半导体技术有限公司(以下简称“广东芯汉奇”)拟与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订

《晶品级先进封装制造项目三期合作协议》(以下简称“本协议”),预计晶品级先进封装制造项目三期(以下简称“本项目”)总投资45亿元人民币,最终以项目建设实际投资开支为准(包括建筑物、构筑物及附属设施、设备投资等)。具体将根据本项目实际进展分阶段投入,最终以项目建设实际投资开支为准。

● 交易实施所需履行的审批及其他相关程序
2026年9月21日召开第四届董事会第二十三次会议,全体董事审议通过了《关于与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订项目合作协议暨对外投资的议案》,公司拟在前期项目投资额的基础上再增加投资约45亿元人民币,最终以项目建设实际投资开支为准(包括建筑物、构筑物及附属设施、设备投资等)。具体将根据本项目实际进展分阶段投入,最终以项目建设实际投资开支为准。

● 晶品级先进封装制造项目一期、二期进展情况
1、投资进展情况:晶品级先进封装制造项目一期、二期计划(具体详见2023年10月28日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订项目合作协议暨对外投资的公告》)已于2023年9月已完成,设备陆续交付中,对应产能约3,000片(2.5D产能)。截至本公告披露日,一期项目已完工,房建设及设备安装调试,二期项目设备陆续进场安装调试,目前处于客户试产、工艺验证及小批量试产阶段,尚未正式产生量产收益。

2、技术准备情况:广东芯汉奇已建成2.5D、2.0D、Fan-out Fan-out等多种先进封装技术。本次二期项目系在前期项目基础上进行的技术升级,建设内容项目与前期项目无本质区别,不涉及新增用地。

● 其他需要提醒投资者重点关注的事项
1、本项目是基于公司战略发展的需要以及对行业市场前景的判断,但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性;项目投入建设后,受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素影响,最终实际实施、生产情况具有不确定性,可能存在未能按期建设完成或未能达到预期收益的风险;

2、广东芯汉奇作为本项目经营实体,承担本协议项下的权利和义务。如果广东芯汉奇无法履约时,公司对广东芯汉奇违反本协议条款的行为承担补充责任,补充责任以公司对广东芯汉奇所持股份比例为限。

(二) 对外投资概述
1、本次交易概述
基于公司的发展战略需要,为把握市场发展机遇,提升公司市场竞争力和综合实力,公司、控股子公司广东芯汉奇(作为晶品级先进封装制造项目一期、二期(以下简称“原项目”),三期实施主体),拟与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订《晶品级先进封装制造项目三期合作协议》。本项目总投资额约为45亿元人民币(最终以项目建设实际投资开支为准)。其中固定资产投资40亿元(包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资)。

2、本次交易的主要内容
● 投资标的名称:晶品级先进封装制造项目三期(以下简称“本项目”)

● 投资金额:深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称“公司”)、控股子公司广东芯汉奇半导体技术有限公司(以下简称“广东芯汉奇”)拟与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订

《晶品级先进封装制造项目三期合作协议》(以下简称“本协议”),预计晶品级先进封装制造项目三期(以下简称“本项目”)总投资45亿元人民币,最终以项目建设实际投资开支为准(包括建筑物、构筑物及附属设施、设备投资等)。具体将根据本项目实际进展分阶段投入,最终以项目建设实际投资开支为准。

● 交易实施所需履行的审批及其他相关程序
2026年9月21日召开第四届董事会第二十三次会议,全体董事审议通过了《关于与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订项目合作协议暨对外投资的议案》,公司拟在前期项目投资额的基础上再增加投资约45亿元人民币,最终以项目建设实际投资开支为准(包括建筑物、构筑物及附属设施、设备投资等)。具体将根据本项目实际进展分阶段投入,最终以项目建设实际投资开支为准。

● 晶品级先进封装制造项目一期、二期进展情况
1、投资进展情况:晶品级先进封装制造项目一期、二期计划(具体详见2023年10月28日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订项目合作协议暨对外投资的公告》)已于2023年9月已完成,设备陆续交付中,对应产能约3,000片(2.5D产能)。截至本公告披露日,一期项目已完工,房建设及设备安装调试,二期项目设备陆续进场安装调试,目前处于客户试产、工艺验证及小批量试产阶段,尚未正式产生量产收益。

2、技术准备情况:广东芯汉奇已建成2.5D、2.0D、Fan-out Fan-out等多种先进封装技术。本次二期项目系在前期项目基础上进行的技术升级,建设内容项目与前期项目无本质区别,不涉及新增用地。

● 其他需要提醒投资者重点关注的事项
1、本项目是基于公司战略发展的需要以及对行业市场前景的判断,但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性;项目投入建设后,受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素影响,最终实际实施、生产情况具有不确定性,可能存在未能按期建设完成或未能达到预期收益的风险;

2、广东芯汉奇作为本项目经营实体,承担本协议项下的权利和义务。如果广东芯汉奇无法履约时,公司对广东芯汉奇违反本协议条款的行为承担补充责任,补充责任以公司对广东芯汉奇所持股份比例为限。

(二) 对外投资概述
1、本次交易概述
基于公司的发展战略需要,为把握市场发展机遇,提升公司市场竞争力和综合实力,公司、控股子公司广东芯汉奇(作为晶品级先进封装制造项目一期、二期(以下简称“原项目”),三期实施主体),拟与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订《晶品级先进封装制造项目三期合作协议》。本项目总投资额约为45亿元人民币(最终以项目建设实际投资开支为准)。其中固定资产投资40亿元(包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资)。

2、本次交易的主要内容
● 投资标的名称:晶品级先进封装制造项目三期(以下简称“本项目”)

● 投资金额:深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称“公司”)、控股子公司广东芯汉奇半导体技术有限公司(以下简称“广东芯汉奇”)拟与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订

《晶品级先进封装制造项目三期合作协议》(以下简称“本协议”),预计晶品级先进封装制造项目三期(以下简称“本项目”)总投资45亿元人民币,最终以项目建设实际投资开支为准(包括建筑物、构筑物及附属设施、设备投资等)。具体将根据本项目实际进展分阶段投入,最终以项目建设实际投资开支为准。

● 交易实施所需履行的审批及其他相关程序
2026年9月21日召开第四届董事会第二十三次会议,全体董事审议通过了《关于与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订项目合作协议暨对外投资的议案》,公司拟在前期项目投资额的基础上再增加投资约45亿元人民币,最终以项目建设实际投资开支为准(包括建筑物、构筑物及附属设施、设备投资等)。具体将根据本项目实际进展分阶段投入,最终以项目建设实际投资开支为准。

● 晶品级先进封装制造项目一期、二期进展情况
1、投资进展情况:晶品级先进封装制造项目一期、二期计划(具体详见2023年10月28日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订项目合作协议暨对外投资的公告》)已于2023年9月已完成,设备陆续交付中,对应产能约3,000片(2.5D产能)。截至本公告披露日,一期项目已完工,房建设及设备安装调试,二期项目设备陆续进场安装调试,目前处于客户试产、工艺验证及小批量试产阶段,尚未正式产生量产收益。

2、技术准备情况:广东芯汉奇已建成2.5D、2.0D、Fan-out Fan-out等多种先进封装技术。本次二期项目系在前期项目基础上进行的技术升级,建设内容项目与前期项目无本质区别,不涉及新增用地。

● 其他需要提醒投资者重点关注的事项
1、本项目是基于公司战略发展的需要以及对行业市场前景的判断,但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性;项目投入建设后,受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素影响,最终实际实施、生产情况具有不确定性,可能存在未能按期建设完成或未能达到预期收益的风险;

2、广东芯汉奇作为本项目经营实体,承担本协议项下的权利和义务。如果广东芯汉奇无法履约时,公司对广东芯汉奇违反本协议条款的行为承担补充责任,补充责任以公司对广东芯汉奇所持股份比例为限。

(二) 对外投资概述
1、本次交易概述
基于公司的发展战略需要,为把握市场发展机遇,提升公司市场竞争力和综合实力,公司、控股子公司广东芯汉奇(作为晶品级先进封装制造项目一期、二期(以下简称“原项目”),三期实施主体),拟与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订《晶品级先进封装制造项目三期合作协议》。本项目总投资额约为45亿元人民币(最终以项目建设实际投资开支为准)。其中固定资产投资40亿元(包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资)。

2、本次交易的主要内容
● 投资标的名称:晶品级先进封装制造项目三期(以下简称“本项目”)

● 投资金额:深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称“公司”)、控股子公司广东芯汉奇半导体技术有限公司(以下简称“广东芯汉奇”)拟与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订

《晶品级先进封装制造项目三期合作协议》(以下简称“本协议”),预计晶品级先进封装制造项目三期(以下简称“本项目”)总投资45亿元人民币,最终以项目建设实际投资开支为准(包括建筑物、构筑物及附属设施、设备投资等)。具体将根据本项目实际进展分阶段投入,最终以项目建设实际投资开支为准。

● 交易实施所需履行的审批及其他相关程序
2026年9月21日召开第四届董事会第二十三次会议,全体董事审议通过了《关于与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订项目合作协议暨对外投资的议案》,公司拟在前期项目投资额的基础上再增加投资约45亿元人民币,最终以项目建设实际投资开支为准(包括建筑物、构筑物及附属设施、设备投资等)。具体将根据本项目实际进展分阶段投入,最终以项目建设实际投资开支为准。

(5)在本协议履行期间,如因战争、国家宏观调控、国家或者政府相关法律法规、政策的大调整等不可归责于本项目的、总体将根据本项目实际进展分阶段投入,最终以